



TIF®050AB-11S 一种具备高导热的液态间隙填充材料，具有双组份及不同温度固化时间特点，专为满足低应力和高压缩模量需求而设计。导热凝胶在与电子产品组装时，能够实现良好的接触，表现出较低的接触热阻和优良的电气绝缘特性。固化后的导热凝胶等同于导热硅胶片，具备耐高温和耐老化性能。

特性

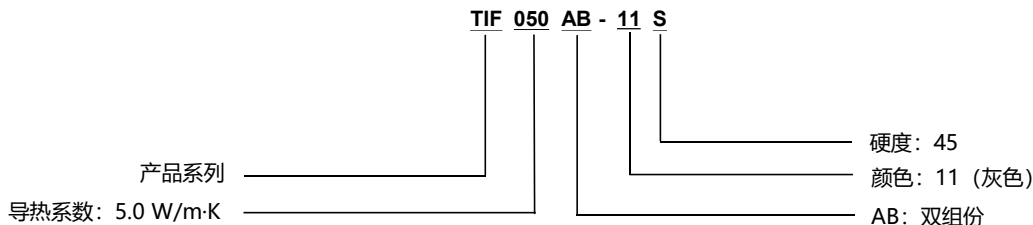
- 》高的热传导率
- 》双组份材料，易于储存
- 》优异的高低温机械性能及化学稳定性
- 》适用于低压力环境
- 》可依温度调整固化时间
- 》可用自动化设备调整厚度

应用

- 》计算机硬件
- 》通信设备
- 》汽车用电子设备
- 》导热减震设备
- 》散热片及半导体

TIF®050AB-11S 特性表		
未固化材料特性		
产品特性	典型值	测试方法
结构&成份	陶瓷填充硅材料	-
A组份颜色	白色	目视
B组份颜色	灰色	目视
A组份黏度 (mPa·s)	2,800,000	GB/T 10247
B组份黏度 (mPa·s)	3,000,000	GB/T 10247
热阻抗 (°C·in ² /W) @10psi	0.08	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @50psi	0.07	ASTM D5470
最小界面厚度 (mm)	0.1	-
混合比例	1:1	-
保存期限 (月)	12	-
固化条件		
操作时间 @25°C	30 分钟	兆科测试
固化时间 @25°C	120 分钟	兆科测试
固化时间 @100°C	30 分钟	兆科测试
固化后材料性能		
颜色	灰色	目视
硬度 (Shore OO)	45	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.2	ASTM D792
导热系数 (W/m·K)	5.0	ASTM D5470
击穿强度 (V/mm)	≥5500	ASTM D149
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200	-
阻燃等级	V-0	UL 94

产品型号说明



产品规格

50 cc/支， 400 cc/支， 或用于自动化应用的定制包装。
如想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案：在地服务
中国：+86-769-38801208
台湾：+886-2-2277-1007
加拿大：+001-604-2998559
越南：+84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF050AB-11S-0526